



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20071017000A
2008 年 9 月 16 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎

SOT(5/6pin DBV)パッケージ一部製品 製造サイト 追加変更のご案内

(部材訂正及び対象除外 1 製品の連絡)

(初版 PCN20071017000 2008 年 3 月 14 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Test	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	下記変更についての部材訂正及び対象除外 1 製品の連絡になります。 SOT(5/6pin DBV)パッケージ一部製品 製造サイト 追加 現行：Lingsen 社(台湾) 変更後：Lingsen 社(台湾)、UTAC 社(タイランド:旧 NSE 社)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	6 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	－			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、初版にて連絡させていただきました内容についての部材訂正及び対象除外1製品の連絡になります。対象製品中の12製品についてマウントコンパウンドを誤って“ABLESTIK 84-1LMISR4”での製造と記載しておりました。これを“ABLESTIK 8006NS”に訂正し連絡させていただきます。対象製品リストについては、各部材ごとに対象製品を訂正させていただきます。尚、認定試験結果につきましては、4/28/2008及び2/1/2008付けのものをご参照下さい。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) SOT(5/6pin DBV)パッケージ一部製品 製造サイトについて、現行Lingsen社(台湾)にて実施していますが、これに加えUTAC社(タイランド: IJNSE社)サイトを追加し認定しました。この変更に伴い各製造サイトにて量産に適用しております下記の部材の使用となります。尚、UTAC社(タイランド: IJNSE社)でのDBVパッケージ製品製造は、2004年2月に認定しております。また、出荷梱包部材につきましては、認定したサイトで現在使用しております部材とさせていただきます。

変更内容	現行	変更後
製造サイト	Lingsen社(台湾)	Lingsen社(台湾) UTAC社(タイランド: IJNSE社)

部材項目	Lingsen社(台湾)	UTAC社(タイランド: IJNSE社)
マウントコンパウンド	SUMITOMO CRM-1033BF	ABLESTIK 84-1LMISR4 ABLESTIK 8006NS
モールドコンパウンド	SUMITOMO G600	SUMITOMO G600

理由：製品供給安定確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
□: ABLESTIK 84-1LMISR4適用製品, 取消線: ABLESTIK 84-1LMISR4適用除外製品 薄字右詰: 変更適用除外製品				
SN65220DBVR	SN65LVDS1DBVR	SN65LVDS2DBVR	SN65LVDT2DBVR	SN65LVDT2YDBVR
SN65220DBVRG4	SN65LVDS1DBVRG4	SN65LVDS2DBVRG4	SN65LVDT2DBVRG4	
SN65220DBVT	SN65LVDS1DBVT	SN65LVDS2DBVT	SN65LVDT2DBVT	
SN65220DBVTG4	SN65LVDS1DBVTG4	SN65LVDS2DBVTG4	SN65LVDT2DBVTG4	

対象製品名				
□: ABLESTIK 8006NS適用製品, 薄字右詰: 変更適用除外製品				
SN65LVDS1DBVR	SN65LVDS1DBVTG4	SN65LVDS2DBVT	SN65LVDT2DBVRG4	SN65LVDT2YDBVR
SN65LVDS1DBVRG4	SN65LVDS2DBVR	SN65LVDS2DBVTG4	SN65LVDT2DBVT	
SN65LVDS1DBVT	SN65LVDS2DBVRG4	SN65LVDT2DBVR	SN65LVDT2DBVTG4	

信頼性試験

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	-	終了	2007年5月22日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN65220DBV	Assembly Site:	UTAC /NSE	
Package:	DBV	Pin Count:	6	
信頼性試験結果				
Reliability Test		Condition / Duration	Results	
Manufacturability Qualification (Assembly)		Per TI requirements	Approved	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	—	終了
			2004年2月6日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qualification Device:	TPS62202DBVT	Die Size (mils):	53 x 41
Wafer Fab Site:	TID	Fab Process:	3370A12
Metal1-3:	TiW/AICu.5	Passivation:	10KACN
Assembly Site:	NSE	Package/Pins:	DBV / 5
Mount Compound:	ABL 84-1 LMISR4	Mold Compound:	SUM EME-G600
Bond Wire:	TS-1.0 Au	LF Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu
Moisture Sensitivity Level:	L1-260C	Flammability Rating:	Class UL94-V0
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
		Lot A	Lot B
**Autoclave	121C, 240hrs	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000cys	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000cys	77/0	77/0
Manufacturability Qualification (MQ)	Per TI requirements	Approved	
Note: ** Preconditioning Sequence: Level 1, 260C			

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	-	終了
			2008年4月28日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qualification Device:	SN65LVDS1DBV	Die Rev/ Size(mils)	- / 53 x 41
Wafer fab Site:	FFAB	Technology:	Bi-CMOS
Fab Process:	LIN3B	Metal 1-2:	AICu
Assembly Site:	UTAC /NSE	Package/Pin:	DBV / 5
Mount compound:	8006NS	Mold Compound:	Sumitomo G600
Bond Wire	TS - 1.0mils Au	L/F Composition/ Finish	Cu / NiPdAu
Flammability Rating:	UL 94 V-0	Moisture Sensitivity Level:	LEVEL1-260C
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Results	
Manufacturability Qualification (Assembly)	Per Mfg Site Spec.	Approved	

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	—	終了
			2008年2月1日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qual Device:	TPS2550BDV	Die REV / Size(mils):	A / 47 x 33
Wafer fab Site:	MH8	Technology:	Bi-CMOS
Fab Process:	LBC7	Metal 1-3:	TiN/AICu.5/TiN
Passivation:	Oxinitride 8000A	BOAC/COA Site:	DBUMP
Assembly Site:	UTAC (Former NSE)	Package/ Pin:	DBV / 6
Mount compound:	8006NS NON COND	Mold Compound:	SUMITOMO G600
Wire Bond Method:	2.0 Au mil	L/F Composition/Finish:	Cu / NiPdAu
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
**Steady-state Life Test	155C (240 Hrs)	116/0	
Characterization	-	30/0	
Manufacturability	Per mfg. Site specification	-	
Preconditioning	Level 1 @ 260C peak +0/-5C	-	
**TempCycle	-65C/150C (500, 1000 Cyc)	77/0	
ESD CDM	200V, 500V, 750V, 1000V	3/0	
ESD HBM	2000V HBM	6/0	
Preconditioning Information: ** Preconditioning sequence: JEDEC Level 1-260C			